

Radien Schleif- und Poliermaschine mit Spindel- und Pinolenantrieb



RSP 20

STOCK KONSTRUKTION

Maschinen-Charakteristik

- Hochflexible „All in One“ Radienpoliermaschine zum effizienten Polieren von Präzisionslinsen
- Für die hochgenaue Bearbeitung planer bis randscharfer sphärischer Flächen mit großem Öffnungswinkel
- High-Speed-Polieren mit Membranaufnahme oder Stielchenbearbeitung
- Separate Einstellung der Prozessparameter an jeder Arbeitsstation
- Speicherbare Programmabläufe via Touchdisplay-Bedienung
- Schnittstelle zur Ausgabe und Archivierung von Prozessdaten
- Stufenlos einstellbarer Polierdruck über Membransystem
- Alle Antriebe einzeln regelbar
- SPS-gesteuerte Prozesse
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel
- Programmgesteuerte Poliermittelzuführung
- Ablagefläche für Werkzeuge



Optionen

- Poliermittelbehälter
- OPC UA Standard

Weitere Optionen, Werkzeuge und Zubehör sind auf Anfrage verfügbar

Technische Daten

	RSP 20-2	RSP 20-3
Anzahl Arbeitsstationen	2	3
Werkstückdurchmesser (max.)	20 mm	
Schwenkbereich	-15 bis 45 °	
Oszillationsgeschwindigkeit	0 - 60 min ⁻¹	
Spindeldrehzahl oben	0 +/- 1200 min ⁻¹	
Spindeldrehzahl unten	0 +/- 2500 min ⁻¹	
Anschlussgewinde Spindel oben	M10 (DIN 58725)	
Anschlussgewinde Spindel unten	M10 (DIN 58725)	
Abstand Aufzugsfläche Spindel oben bis Mitte Schwenkachse (ca.)	20 - 70 mm	
Abstand Aufzugsfläche Spindel unten bis Mitte Schwenkachse (ca.)	50 - 80 mm	
Arbeitsdruck	0 - 5 bar	
Breite	800 mm	1305 mm
Tiefe	1251 mm	
Höhe bis Tischplatte / Display	932 / 1725 mm	
Gewicht (ca.)	580 kg	670 kg
Leistungsbedarf (ca.)	2,5 kW	4,6 kW
Lackierung (Standard)	Lichtgrau RAL 7035	